

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 8 月 18 日(18.08.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/099371 A1

- (51) 国際特許分類:
G01R 1/067 (2006.01) C25D 1/02 (2006.01)
C23F 1/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/051560
- (22) 国際出願日: 2011 年 1 月 27 日(27.01.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-029354 2010 年 2 月 12 日(12.02.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ルス・コム (LuzCom Inc.) [JP/JP]; 〒6150854 京都府京都市右京区西京極堤外町 1 0 番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小島袈裟雄 (KOJIMA Kesao) [JP/JP]; 〒6150854 京都府京都市右京区西京極堤外町 1 0 番地 株式会社ルス・コム内 Kyoto (JP). 市川裕 (ICHIKAWA Yutaka) [JP/JP]; 〒6150854 京都府京都市右京区西京極

堤外町 1 0 番地 株式会社ルス・コム内 Kyoto (JP).

(74) 代理人: 鈴木正次, 外 (SUZUKI Shoji et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿 1-10-3 太田紙興新宿ビル 9 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

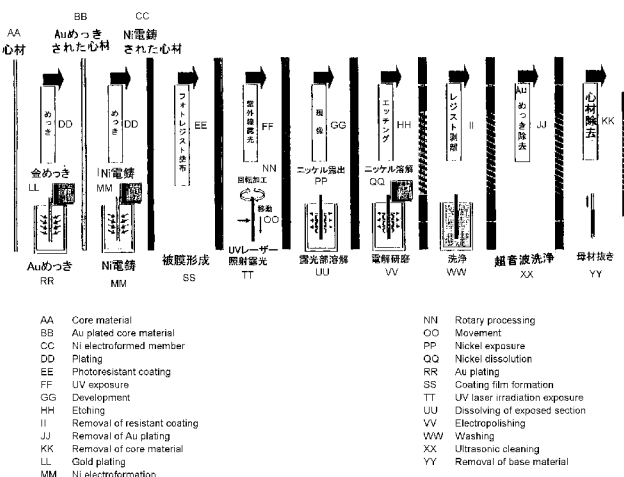
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) Title: MANUFACTURING METHOD FOR CONTACT FOR CURRENT INSPECTION JIG, CONTACT FOR CURRENT INSPECTION JIG MANUFACTURED USING SAID METHOD, AND CURRENT INSPECTION JIG PROVIDED WITH SAID CONTACT

(54) 発明の名称: 通電検査治具用接触子の製造方法及び、これにより製造した通電検査治具用接触子、並びにこれを備えている通電検査治具

【図2】



(57) Abstract: Disclosed is a manufacturing method which enables more accurate and precise manufacturing of an ultra-fine, thin contact for current inspection jigs which is provided with a spring structure. After a metal or gold alloy plating layer is formed by plating the outer periphery of a core material, an Ni electroformed layer is formed by electroformation on the outer periphery of the formed plating layer. After a resistant layer is formed on the outer periphery of the Ni electroformed layer, a spiral groove is formed in the resistant layer by laser exposure, and etching is carried out using the resistant layer as a masking material. The Ni electroformed layer is removed from the part of the resistant layer where the spiral groove was formed, and then the resistant layer is removed and the plating layer is removed from the part of the spiral groove section where the Ni electroformed layer was removed. The core material is then removed, leaving the plating layer inside the periphery of the Ni electroformed layer.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/099371 A1